當藝術遇見化學:用化學蝕刻製作銅板作品

廖旭茂

臺中市立大甲高級中學教育部高中化學學科中心*nacl880626@hotmail.com

■ 簡介

先前筆者在本期刊《臺灣化學教育》第二十期發表〈大型印台和銅板電化學蝕刻製作〉·利用電解蝕刻(electrolytic etching)·使金屬表面出現具有凹凸對比的立體圖案。在楊水平教授的邀請下·在本期「當藝術遇見化學」專題撰寫相關文章·筆者嘗試利用其他化學方法進行蝕刻教學·並設計為化學與藝術結合的特色選修課程教學活動。

進行化學蝕刻可分為兩方面:第一方面 是圖案的繪製與設計;第二方面是化學蝕刻。 前者學生可以在瀝青或軟蠟等疏水性材料的 覆蓋下,自行用金屬雕刻筆刀在銅板上刮除 並繪製圖案,筆者在就讀國中時的工藝科的 金工課程即是如此。若學生具有美術背景者, 藝術效果會較好,製作的圖案具有美感。

學生也可以利用現成繪製設計好的圖案 或模板,網路上有很多共享的設計圖提供給 一般大眾使用 ¹。關於金屬片貼上圖案的方法 有數種 · 其一是卡典西得貼紙法 · 主要是 · 利 用割字機 · 透過電腦設計圖 · 在卡點西得貼 紙上割出圖案 · 再用鑷子尖端挑去部分貼紙 後 · 再轉貼到金屬板上 · 相關做法筆者在本 刊物已介紹過 ² 。其二是利用雷射印表機 · 列

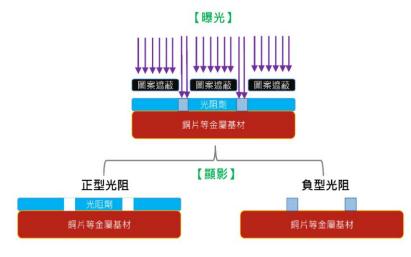


圖 1:PCB 微影蝕刻示意圖

化學蝕刻方面可分為三種方法:強酸腐蝕法、氯化鐵腐蝕法、雙氧水加 EDTA 腐蝕

法。綜合來說,硝酸腐蝕銅板會產生有毒的二氧化氮氣體,必須在排煙櫃中進行,不環保也不很方便,基本上不建議使用,本文不介紹利用硝酸腐蝕銅板來製作銅板蝕刻,僅介紹後兩種;氯化鐵腐蝕的效果最好,不過產生的銅鐵混合廢液不好處理;最後的雙氧水蝕刻,蝕刻速率較慢,不容易在兩節課中完成,好處是反應不產生有毒廢氣,銅離子可以用電解法回收,算是三種化學方法中較符合綠色規範的。

本次實驗利用美術材料行販售的彩繪用 塑膠模板·直接貼於銅板上後·以膠帶固定; 模板鏤空的部分·隨即被氧化侵蝕凹陷·模 板被遮蓋的部分·則維持不反應。兩種化學 蝕刻結束後,直接將膠帶撕起,用過的塑膠 模板可以重複再使用。用清水沖洗銅板後, 完成蝕刻活動。圖 2 為兩種化學蝕刻比較圖。



圖 2:兩種化學蝕刻反應過程·圖左蝕刻液 為氯化鐵·圖右蝕刻液為雙氧水加 EDTA-4Na

■ 藥品與材料

本實驗所需藥品和材料:銅片(厚 0.5 mm,可依需求裁切出所需尺寸)、彩繪用彈性模板(flex stencils)、透明膠帶、塑膠淺盤、金屬亮光膏、擦拭棉紙、雙氧水(30% H_2O_2) 20 mL、0.5 M 乙二胺四醋酸四鈉(EDTA-4Na)20 mL、1 M 氯化鐵(FeCl₃)40 mL。

■ 實驗步驟

1. 取一購自美術材料行的彈性模板,常用 於紙張、陶、木製品的裝飾上色,具有 一定的黏性,可穩定黏著於光滑的金屬 片上,實驗畢以清水沖洗後晾乾,可再 拉起重複使用。同學使用時可依喜好、 選取相關圖案。圖3:為市售的彈性模 板。



圖 3: 可撕式並重複使用的彈性模板

2. 裁剪一塊大小接近的銅片,用藥用酒精 擦拭表面油漬,乾燥後備用。取彈性模 板貼在銅片上,接著以透明膠帶黏貼四 周與背面。圖 4 為蝕刻準備圖。





圖 4:金屬前、後面圖案外的空白處皆以 透明膠帶黏貼密封

3. 取一個塑膠淺底盤,置入銅片後,再倒入1M的氯化鐵溶液約40毫升,溶液量洽蓋過銅片即可,蝕刻過程中銅片會被氧化成難溶於水的氯化亞銅,可事先準備毛刷,輕輕刷除鏤空面的紅棕色沉澱,仔細觀察溶液的變化,蝕刻30分鐘後取出,並以清水沖洗乾淨。圖5氯化鐵蝕刻的過程。





圖 5:倒入黃褐色的氯化鐵溶液 (左)·蝕 刻 10 分鐘後溶液漸漸變成綠色 (右)

4. 承上步驟·取一塊銅片和彈性模板·以 膠帶黏貼穩妥後·用 20 mL 的 30% 雙

氧水和 20 mL 的 0.5 M 的 EDTA-4Na 混合溶液取代氯化鐵溶液,仔細觀察銅片 鏤空處和溶液的顏色變化。推測產生的 泡泡為何種氣體?在進行蝕刻 30 分鐘後,取出銅片,以清水沖洗,並撕開膠帶和模板,模板清洗後陰乾,可供下次使用,圖 6 為雙氧水進行銅板蝕刻。



圖 6:剛開始銅板表面產生氣泡(左)·一 段時間後溶液變成綠色(右)

5. 在步驟 3 和 4 的蝕刻的成品陰乾後,以 金屬拋光劑來回擦拭直到光亮為止,最 後噴上透明保護漆,做防鏽處理。圖 7 為成品加工處理。







圖 7:成品後續加工處理

6. 完成的作品如圖 8 所示。





圖 8: 蝕刻作品:使用氯化鐵溶液(左)和 雙氧水加 EDTA-4Na 混合溶液(右)

■ 原理與概念

本實驗利用兩種方法,進行化學蝕刻。 第一種方法是氯化鐵的蝕刻、第二種方法是 雙氧水加入 EDTA-4Na 的蝕刻,其原理和概 念分述如下。

氯化鐵是中度的氧化劑,多用於銅、鎳金屬的表面處理,尤其是電路板的蝕刻,具有反應溫和,不產生氣泡的優點。若使用其他方法而快速生成的氣泡,則會影響圖案邊緣,滲入保護中的金屬層,進而降低畫面線條的解析度。三價鐵還原成三價鐵的還原電位為+0.77 V,而銅的氧化電位為-0.34 V,由全反應的電位來看,兩者電位差為+0.43 V,大於零。三價的氯化鐵溶液,可以氧化金屬銅,或活性大於鐵的金屬。氯化鐵蝕刻法可能涉及三個反應,如式[1]、[2]和[3]所示 5.6:

$$FeCl_3(aq) + Cu(s) \rightarrow FeCl_2(aq) + CuCl(s)$$

[1]

$$FeCl_{3}(aq) + CuCl(s) \rightarrow FeCl_{2}(aq) +$$

$$CuCl_{2}(aq) \qquad [2]$$

$$CuCl_{2}(aq) + Cu(s) \rightarrow 2CuCl(aq) \qquad [3]$$

雙氧水加入 EDTA-4Na 的混合液與銅的 反應,產牛氣泡的速度不快,蝕刻速度亦較 慢,產物 EDTA 與銅的錯合物毒性較小,也 較單純,可依電解法回收銅離子。雙氧水屬 於強氧化劑,還原成水的還原電位高達 1.77 V·幾乎可氧化所有金屬(金離子的還原電位 為 1.53 V)。雙氧化先氧化銅金屬成為銅離 子,而本身還原成水;產物銅離子可催化雙 氧水的分解,因此藉由加入 EDTA-4Na,與銅 離子形成錯合物,根據勒沙特列原理,反應 往產生銅離子的方向進行。使用雙氧水加入 EDTA-4Na 的方法, 進行的反應可能如式[4]、 [5]所示,全反應如式[6]所示。此外,原本生 成的銅離子會促進雙氧水的分解速率,但是 生成的 EDTA 與銅離子形成錯合物卻能夠抑 制雙氧水的分解速率,其反應如式[7]所示。

$$H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + Cu(s) \rightarrow 2H_2O(l) + Cu^{2+}(aq)$$
 [4]

$$Cu^{2+}(aq) + EDTA-4Na(aq) \rightarrow Cu(EDTA)^{2-}$$

 $(aq) + 4Na^{+}(aq)$ [5]

全反應:
$$H_2O_2(aq) + 2H^+(aq) + Cu(s) +$$

$$EDTA-4Na(aq) \rightarrow$$

$$2H_2O(l) + Cu(EDTA)^{2-}(aq) + 4Na^+(aq) \qquad [6]$$

$$2H_2O_2(aq) \stackrel{Cu^{2-}}{\longleftarrow} O_2(g) + 2H_2O(l)$$
[7]

■ 安全注意及廢棄物處理

- 本實驗使用完畢的廢液,因含有重金屬, 請依實驗室廢棄物規定,統一回收處理。
- 若為家庭實驗,含鐵離子與銅離子的酸性腐蝕液,可使用洗滌鹼(碳酸鈉)中和,產生氫氧化銅或氫氧化亞鐵難溶於水的沉澱物。接著用咖啡濾紙過濾、乾燥後丟棄。而濾液可以到入水槽。

■ 參考資料

- 1. Discover & Download Free Vector Art! https://www.vecteezy.com/.
- 2. 廖旭茂 (2017)。大型印台和銅板電化學 蝕刻製作。臺灣化學教育,第二十期, http://chemed.chemistry.org.tw/?p=24182。
- 3. Suen, R. (2009)。碳粉熱轉印法(Toner Transfer)製作 PCB 製作方法介紹及能力測試.

 http://www.qsl.net/bv3fg/tech/TTPCB.htm
- 4. Photoresist, https://en.wikipedia.org/wiki/Photoresist.
- 5. Iron(III) chloride, https://en.wikipedia.org/wiki/Iron(III)_chloride.
- 6. Copper Reactivity: Etching, http://www.schoolscience.co.uk/documentd ownload.axd?documentresourceid=245.